

第一节 重要提示

1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.重大风险提示

公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中披露了可能面对的风险,提请投资者注意查阅。

3.本公司董事会、监事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4.公司全体董事出席了董事会会议。

5.安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6.公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□适用 √不适用

# 上海复旦微电子集团股份有限公司

## 2023年度报告摘要

详细内容公司于2024年3月30日披露的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》。

前次募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下:

序号	募集资金投资项目名称	总投资金额	拟使用募集资金金额	2023年12月31日募集资金项目自筹资金投入金额	募集资金置换金额
1	存储芯片工艺研发及产业化项目	360,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00
2	智能电表研发项目	300,000,000.00	300,000,000.00	74,561,298.30	74,561,298.30
合计				374,561,298.30	374,561,298.30

融合感知和定位能力

物联网时代信息安全需求日益增长,随着无线接入设备数量快速增长,虚拟空间和实体空间的结合更加紧密,网络边界边界模糊,信息安全形势愈加严峻,重工业物联网技术应用的发展,对安全芯片的需求更加迫切,安全芯片在物联网中的应用,可以有效提升物联网的安全防护能力,保障物联网系统的安全运行。

其次,无线通信网络传输能力是实时物联取数据,如何无感知地实现可靠的数据传输,也是物联网应用的重要挑战,无线通信网络传输能力是实时物联取数据,如何无感知地实现可靠的数据传输,也是物联网应用的重要挑战。

(一) 募投项目先期投入及置换情况

(二) 使用部分募集资金永久补充流动资金情况

(三) 募集资金使用与披露情况

(四) 募集资金使用与披露情况

(五) 募集资金使用与披露情况

除上述之外,截至2023年12月31日,公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、前次募集资金投资项目最近三年实现效益情况

截至2023年12月31日,前次募集资金投资项目最近三年实现效益情况如下:

序号	募集资金投资项目名称	截至2023年12月31日募集资金项目自筹资金投入金额	募集资金置换金额
1	存储芯片工艺研发及产业化项目	300,000,000.00	300,000,000.00
2	智能电表研发项目	74,561,298.30	74,561,298.30
合计		374,561,298.30	374,561,298.30

公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□适用 √不适用

(一) 募集资金使用与披露情况

(二) 募集资金使用与披露情况

(三) 募集资金使用与披露情况

(四) 募集资金使用与披露情况

(五) 募集资金使用与披露情况

注:1.存储芯片工艺研发及产业化项目中的主要产品项目于2021年第三季度完成设计定型,该项目所涉产品及项目于2021年度、2022年度、2023年度实现的销售收入金额分别为人民币168,822,510.05元、289,395,022.69元和439,884,563.94元,共计人民币898,670,067.03元。

六、前次发行涉及以及前次认购股份的相关资产情况

本公司不存在前次发行涉及以及前次认购股份的相关资产情况。

第一节 公司简介

一、基本情况

股票种类	股票上市交易所及股票简称	股票代码	股票币种	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	688385	人民币	不适用
B股	上海证券交易所主板	601385	人民币	不适用

二、主要业务

三、主要客户

四、主要供应商

(一) 募集资金使用与披露情况

(二) 募集资金使用与披露情况

(三) 募集资金使用与披露情况

(四) 募集资金使用与披露情况

(五) 募集资金使用与披露情况

注:1.存储芯片工艺研发及产业化项目中的主要产品项目于2021年第三季度完成设计定型,该项目所涉产品及项目于2021年度、2022年度、2023年度实现的销售收入金额分别为人民币168,822,510.05元、289,395,022.69元和439,884,563.94元,共计人民币898,670,067.03元。

六、前次发行涉及以及前次认购股份的相关资产情况

本公司不存在前次发行涉及以及前次认购股份的相关资产情况。

2.报告期内主要业务简介

(一)主要业务、主要产品或服务情况

(二)主要客户

(三)主要供应商

(四)主要原材料

(五)主要能源

(六)主要设备

(七)主要环保

(八)主要安全

(九)主要知识产权

(十)主要诉讼

(十一)其他

(一) 募集资金使用与披露情况

(二) 募集资金使用与披露情况

(三) 募集资金使用与披露情况

(四) 募集资金使用与披露情况

(五) 募集资金使用与披露情况

注:1.存储芯片工艺研发及产业化项目中的主要产品项目于2021年第三季度完成设计定型,该项目所涉产品及项目于2021年度、2022年度、2023年度实现的销售收入金额分别为人民币168,822,510.05元、289,395,022.69元和439,884,563.94元,共计人民币898,670,067.03元。

六、前次发行涉及以及前次认购股份的相关资产情况

本公司不存在前次发行涉及以及前次认购股份的相关资产情况。

产品名称	产品描述	应用领域	产品优势/特点
非挥发存储器	提供多种接口、封装、全面兼容、高性价比的非挥发存储器产品	工业控制、消费电子	高密度、低功耗、长寿命
智能电表芯片	集成MCU、非挥发存储器、智能电表芯片	智能电网、工业控制	高精度、低功耗、高集成度
存储芯片	提供多种接口、封装、全面兼容、高性价比的存储芯片	工业控制、消费电子	高密度、低功耗、长寿命
智能电表芯片	集成MCU、非挥发存储器、智能电表芯片	智能电网、工业控制	高精度、低功耗、高集成度
存储芯片	提供多种接口、封装、全面兼容、高性价比的存储芯片	工业控制、消费电子	高密度、低功耗、长寿命

序号	募集资金投资项目名称	总投资金额	拟使用募集资金金额	2023年12月31日募集资金项目自筹资金投入金额	募集资金置换金额
1	存储芯片工艺研发及产业化项目	360,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00
2	智能电表研发项目	300,000,000.00	300,000,000.00	74,561,298.30	74,561,298.30
合计				374,561,298.30	374,561,298.30

注:1.存储芯片工艺研发及产业化项目中的主要产品项目于2021年第三季度完成设计定型,该项目所涉产品及项目于2021年度、2022年度、2023年度实现的销售收入金额分别为人民币168,822,510.05元、289,395,022.69元和439,884,563.94元,共计人民币898,670,067.03元。

六、前次发行涉及以及前次认购股份的相关资产情况

本公司不存在前次发行涉及以及前次认购股份的相关资产情况。

产品名称	产品描述	应用领域	产品优势/特点
非挥发存储器	提供多种接口、封装、全面兼容、高性价比的非挥发存储器产品	工业控制、消费电子	高密度、低功耗、长寿命
智能电表芯片	集成MCU、非挥发存储器、智能电表芯片	智能电网、工业控制	高精度、低功耗、高集成度
存储芯片	提供多种接口、封装、全面兼容、高性价比的存储芯片	工业控制、消费电子	高密度、低功耗、长寿命
智能电表芯片	集成MCU、非挥发存储器、智能电表芯片	智能电网、工业控制	高精度、低功耗、高集成度
存储芯片	提供多种接口、封装、全面兼容、高性价比的存储芯片	工业控制、消费电子	高密度、低功耗、长寿命

序号	募集资金投资项目名称	总投资金额	拟使用募集资金金额	2023年12月31日募集资金项目自筹资金投入金额	募集资金置换金额
1	存储芯片工艺研发及产业化项目	360,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00
2	智能电表研发项目	300,000,000.00	300,000,000.00	74,561,298.30	74,561,298.30
合计				374,561,298.30	374,561,298.30

注:1.存储芯片工艺研发及产业化项目中的主要产品项目于2021年第三季度完成设计定型,该项目所涉产品及项目于2021年度、2022年度、2023年度实现的销售收入金额分别为人民币168,822,510.05元、289,395,022.69元和439,884,563.94元,共计人民币898,670,067.03元。

六、前次发行涉及以及前次认购股份的相关资产情况

本公司不存在前次发行涉及以及前次认购股份的相关资产情况。

产品名称	产品描述	应用领域	产品优势/特点
非挥发存储器	提供多种接口、封装、全面兼容、高性价比的非挥发存储器产品	工业控制、消费电子	高密度、低功耗、长寿命
智能电表芯片	集成MCU、非挥发存储器、智能电表芯片	智能电网、工业控制	高精度、低功耗、高集成度
存储芯片	提供多种接口、封装、全面兼容、高性价比的存储芯片	工业控制、消费电子	高密度、低功耗、长寿命
智能电表芯片	集成MCU、非挥发存储器、智能电表芯片	智能电网、工业控制	高精度、低功耗、高集成度
存储芯片	提供多种接口、封装、全面兼容、高性价比的存储芯片	工业控制、消费电子	高密度、低功耗、长寿命

序号	募集资金投资项目名称	总投资金额	拟使用募集资金金额	2023年12月31日募集资金项目自筹资金投入金额	募集资金置换金额
1	存储芯片工艺研发及产业化项目	360,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00
2	智能电表研发项目	300,000,000.00	300,000,000.00	74,561,298.30	74,561,298.30
合计				374,561,298.30	374,561,298.30

注:1.存储芯片工艺研发及产业化项目中的主要产品项目于2021年第三季度完成设计定型,该项目所涉产品及项目于2021年度、2022年度、2023年度实现的销售收入金额分别为人民币168,822,510.05元、289,395,022.69元和439,884,563.94元,共计人民币898,670,067.03元。

六、前次发行涉及以及前次认购股份的相关资产情况

本公司不存在前次发行涉及以及前次认购股份的相关资产情况。

产品名称	产品描述	应用领域	产品优势/特点
非挥发存储器	提供多种接口、封装、全面兼容、高性价比的非挥发存储器产品	工业控制、消费电子	高密度、低功耗、长寿命
智能电表芯片	集成MCU、非挥发存储器、智能电表芯片	智能电网、工业控制	高精度、低功耗、高集成度
存储芯片	提供多种接口、封装、全面兼容、高性价比的存储芯片	工业控制、消费电子	高密度、低功耗、长寿命
智能电表芯片	集成MCU、非挥发存储器、智能电表芯片	智能电网、工业控制	高精度、低功耗、高集成度
存储芯片	提供多种接口、封装、全面兼容、高性价比的存储芯片	工业控制、消费电子	高密度、低功耗、长寿命

序号	募集资金投资项目名称	总投资金额	拟使用募集资金金额	2023年12月31日募集资金项目自筹资金投入金额	募集资金置换金额
1	存储芯片工艺研发及产业化项目	360,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00
2	智能电表研发项目	300,000,000.00	300,000,000.00	74,561,298.30	74,561,298.30
合计				374,561,298.30	374,561,298.30

注:1.存储芯片工艺研发及产业化项目中的主要产品项目于2021年第三季度完成设计定型,该项目所涉产品及项目于2021年度、2022年度、2023年度实现的销售收入金额分别为人民币168,822,510.05元、289,395,022.69元和439,884,563.94元,共计人民币898,670,067.03元。

六、前次发行涉及以及前次认购股份的相关资产情况

本公司不存在前次发行涉及以及前次认购股份的相关资产情况。

第一节 重要提示

1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.重大风险提示

公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中披露了可能面对的风险,提请投资者注意查阅。

3.本公司董事会、监事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4.公司全体董事出席了董事会会议。

5.安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6.公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□适用 √不适用

# 上海复旦微电子集团股份有限公司

## 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

详细内容公司于2024年3月30日披露的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》。

前次募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下:

序号	募集资金投资项目名称	总投资金额	拟使用募集资金金额	2023年12月31日募集资金项目自筹资金投入金额	募集资金置换金额
1	存储芯片工艺研发及产业化项目	360,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00
2	智能电表研发项目	300,000,000.00	300,000,000.00	74,561,298.30	74,561,298.30
合计				374,561,298.30	374,561,298.30

融合感知和定位能力

物联网时代信息安全需求日益增长,随着无线接入设备数量快速增长,虚拟空间和实体空间的结合更加紧密,网络边界边界模糊,信息安全形势愈加严峻,重工业物联网技术应用的发展,对安全芯片的需求更加迫切,安全芯片在物联网中的应用,可以有效提升物联网的安全防护能力,保障物联网系统的安全运行。

其次,无线通信网络传输能力是实时物联取数据,如何无感知地实现可靠的数据传输,也是物联网应用的重要挑战,无线通信网络传输能力是实时物联取数据,如何无感知地实现可靠的数据传输,也是物联网应用的重要挑战。

(一) 募集资金使用与披露情况

(二) 募集资金使用与披露情况

(三) 募集资金使用与披露情况

(四) 募集资金使用与披露情况

(五) 募集资金使用与披露情况

注:1.存储芯片工艺研发及产业化项目中的主要产品项目于2021年第三季度完成设计定型,该项目所涉产品及项目于2021年度、2022年度、2023年度实现的销售收入金额分别为人民币168,822,510.05元、289,395,022.69元和439,884,563.94元,共计人民币898,670,067.03元。

六、前次发行涉及以及前次认购股份的相关资产情况

本公司不存在前次发行涉及以及前次认购股份的相关资产情况。

产品名称	产品描述	应用领域	产品优势/特点
非挥发存储器	提供多种接口、封装、全面兼容、高性价比的非挥发存储器产品	工业控制、消费电子	高密度、低功耗、长寿命
智能电表芯片	集成MCU、非挥发存储器、智能电表芯片	智能电网、工业控制	高精度、低功耗、高集成度
存储芯片	提供多种接口、封装、全面兼容、高性价比的存储芯片	工业控制、消费电子	高密度、低功耗、长寿命
智能电表芯片	集成MCU、非挥发存储器、智能电表芯片	智能电网、工业控制	高精度、低功耗、高集成度
存储芯片	提供多种接口、封装、全面兼容、高性价比的存储芯片	工业控制、消费电子	高密度、低功耗、长寿命

序号	募集资金投资项目名称	总投资金额	拟使用募集资金金额	2023年12月31日募集资金项目自筹资金投入金额	募集资金置换金额
1	存储芯片工艺研发及产业化项目	360,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00
2	智能电表研发项目	300,000,000.00	300,000,000.00	74,561,298.30	74,561,298.30
合计				374,561,298.30	374,561,298.30

注:1.存储芯片工艺研发及产业化项目中的主要产品项目于2021年第三季度完成设计定型,该项目所涉产品及项目于2021年度、2022年度、2023年度实现的销售收入金额分别为人民币168,822,510.05元、289,395,022.69元和439,884,563.94元,共计人民币898,670,067.03元。

六、前次发行涉及以及前次认购股份的相关资产情况

本公司不存在前次发行涉及以及前次认购股份的相关资产情况。

产品名称	产品描述	应用领域	产品优势/特点
非挥发存储器	提供多种接口、封装、全面兼容、高性价比的非挥发存储器产品	工业控制、消费电子	高密度、低功耗、长寿命
智能电表芯片	集成MCU、非挥发存储器、智能电表芯片	智能电网、工业控制	高精度、低功耗、高集成度
存储芯片	提供多种接口、封装、全面兼容、高性价比的存储芯片	工业控制、消费电子	高密度、低功耗、长寿命
智能电表芯片	集成MCU、非挥发存储器、智能电表芯片	智能电网、工业控制	高精度、低功耗、高集成度
存储芯片	提供多种接口、封装、全面兼容、高性价比的存储芯片	工业控制、消费电子	高密度、低功耗、长寿命

序号	募集资金投资项目名称	总投资金额	拟使用募集资金金额	2023年12月31日募集资金项目自筹资金投入金额	募集资金置换金额
1	存储芯片工艺研发及产业化项目	360,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00
2	智能电表研发项目	300,000,000.00	300,000,000.00	74,561,298.30	74,561,298.30
合计				374,561,298.30	374,561,298.30

注:1.存储芯片工艺研发及产业化项目中的主要产品项目于2021年第三季度完成设计定型,该项目所涉产品及项目于2021年度、2022年度、2023年度实现的销售收入金额分别为人民币168,822,510.05元、289,395,022.69元和439,884,563.94元,共计人民币898,670,067.03元。

六、前次发行涉及以及前次认购股份的相关资产情况

本公司不存在前次发行涉及以及前次认购股份的相关资产情况。